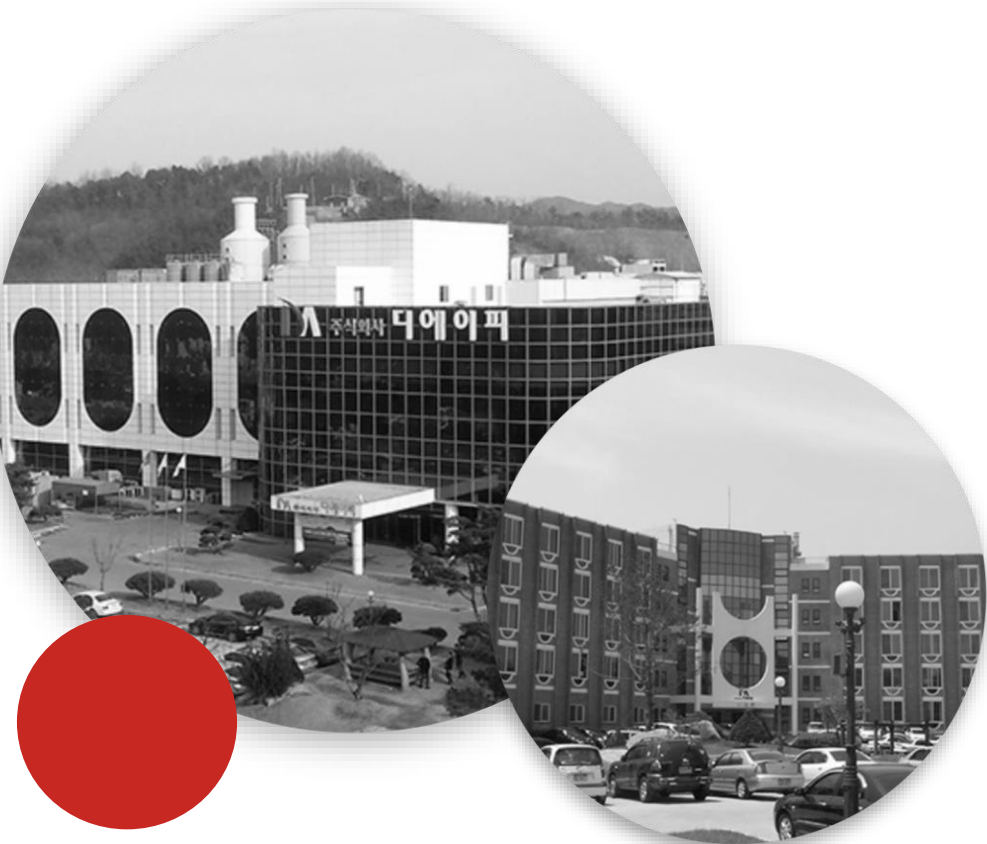
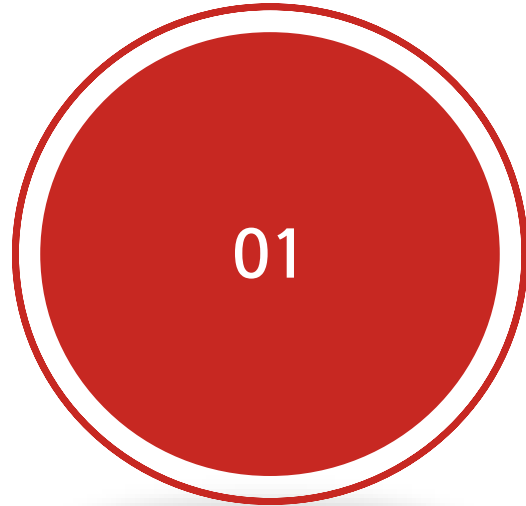


2024 한경국립대학교 기업분석 경진대회

 (주)디에이피

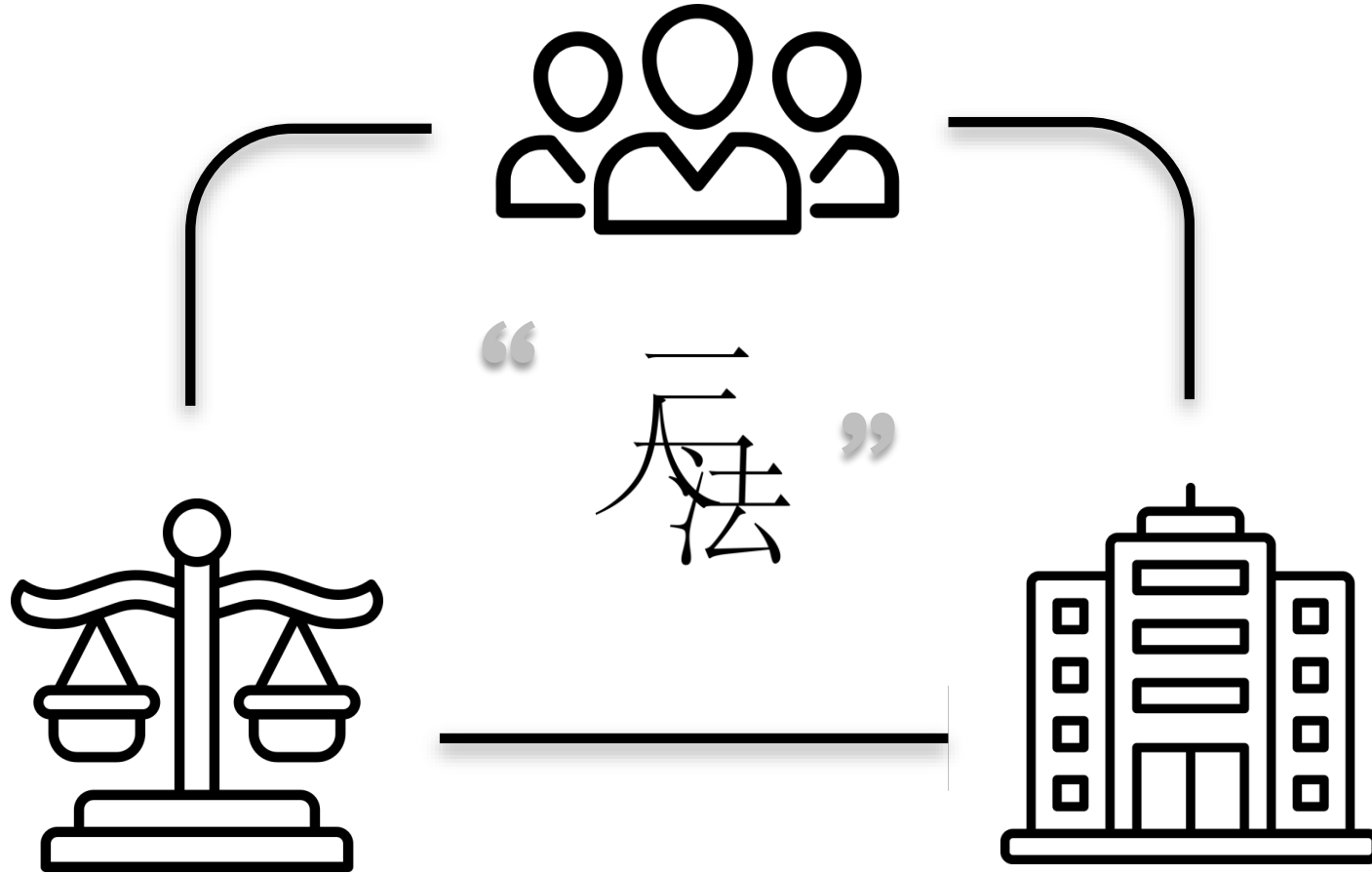
삼법인

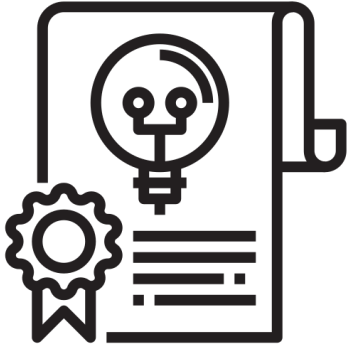




팀 소개 및 기업 선정 이유

三
人
法





상법의 특허 내용에 관심

...



특허 보유 중견기업 탐색

...

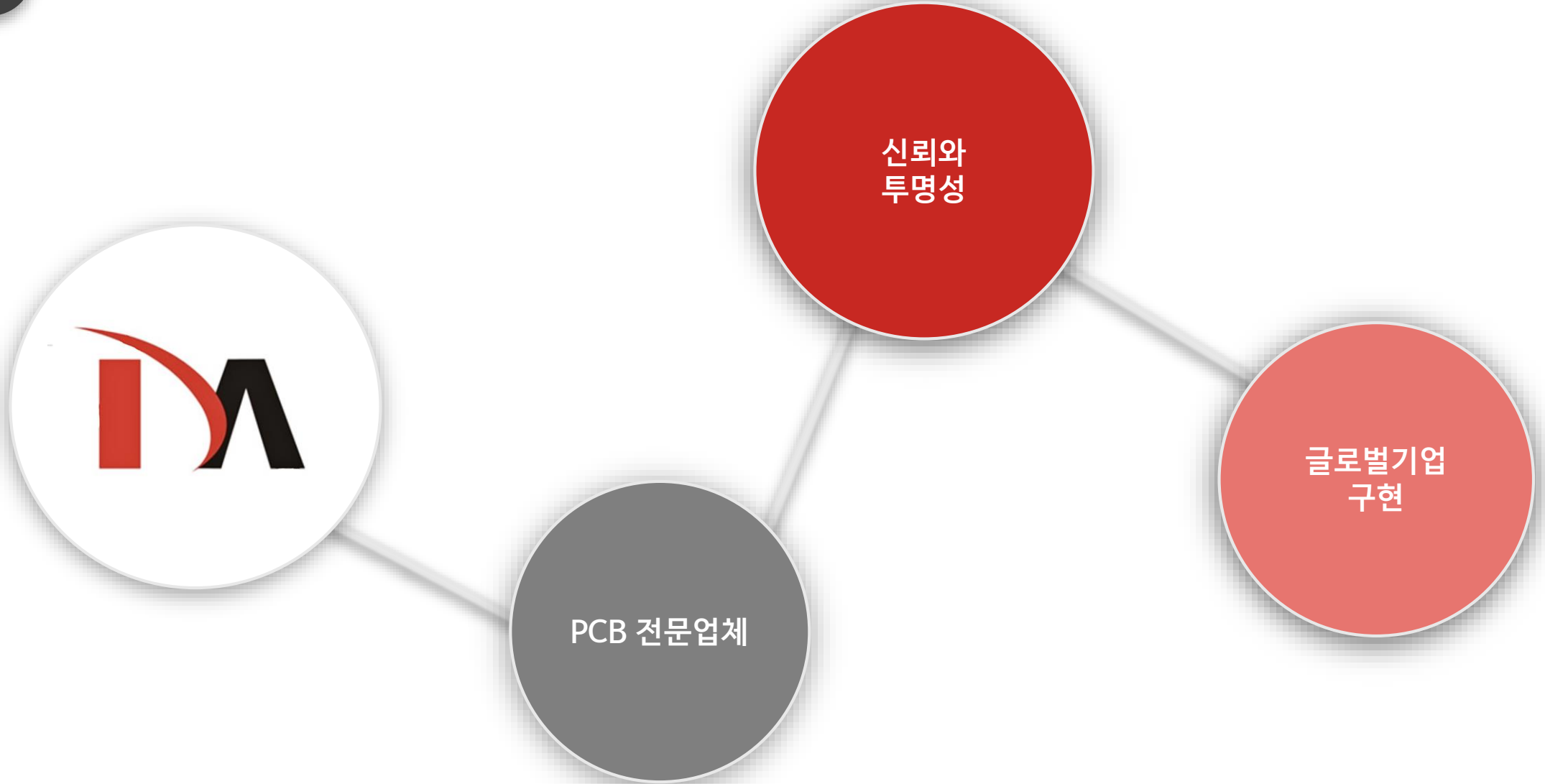


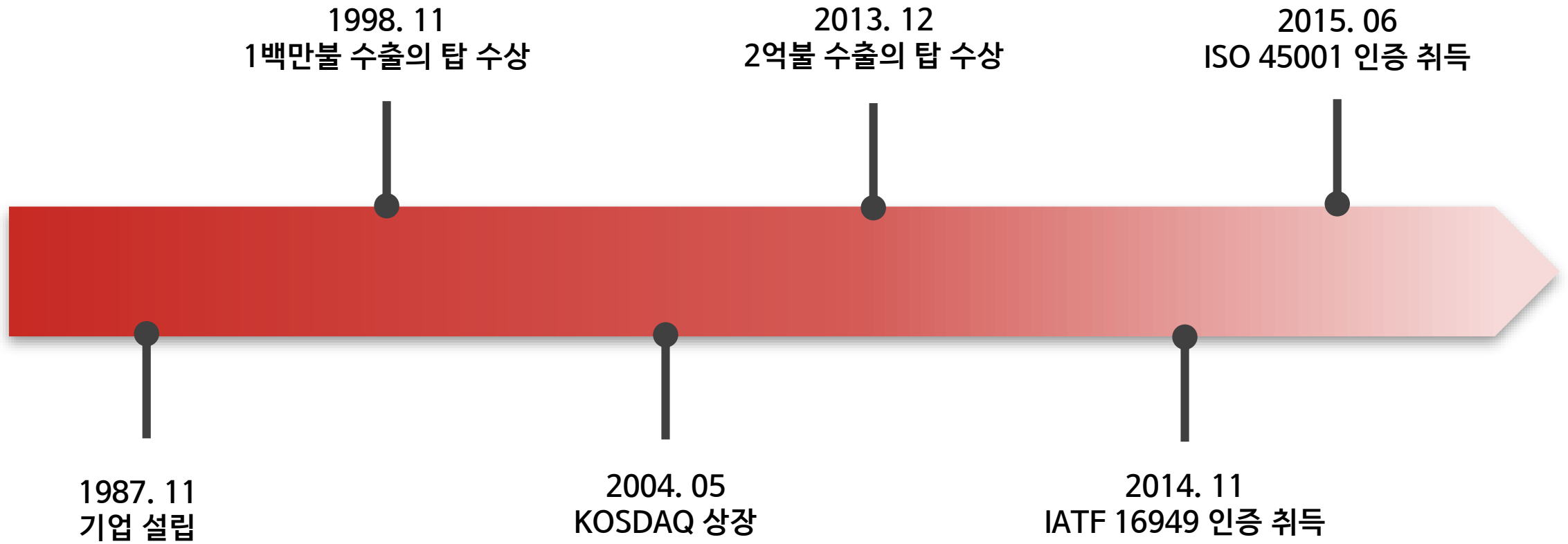
신기술 공법 개발 등
다양한 특허를 가진
디에이피 선정



기업 소개

三
人
法







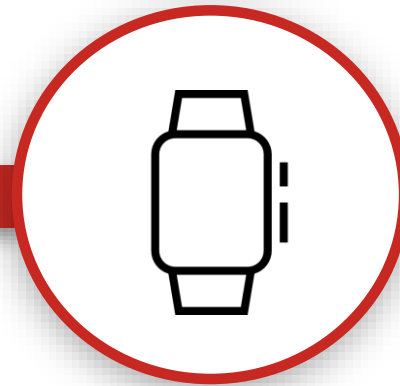
MOBILE PHONE
HDI PCB



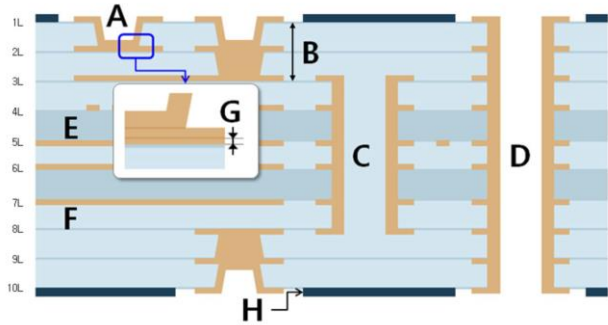
TABLET
HDI PCB



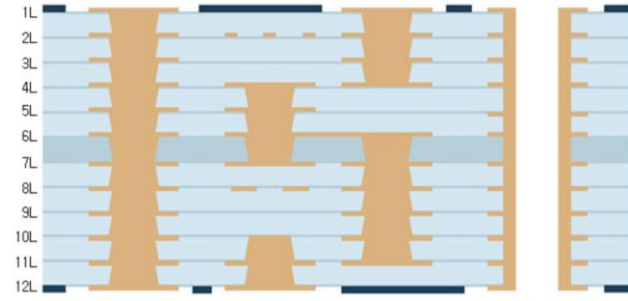
AUTOMOBILE
HDI PCB



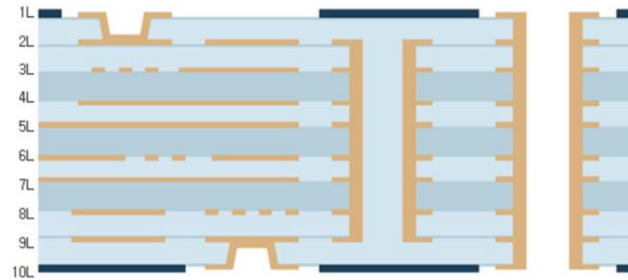
WEARABLE
HDI PCB



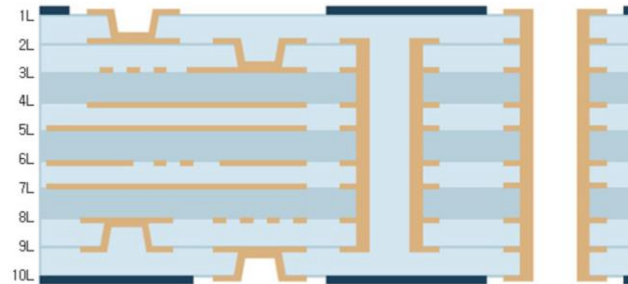
• HDI PCB



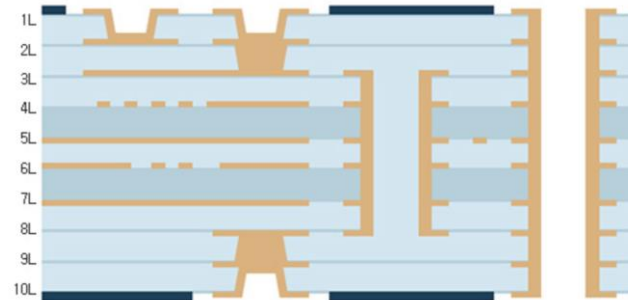
• Any Layer



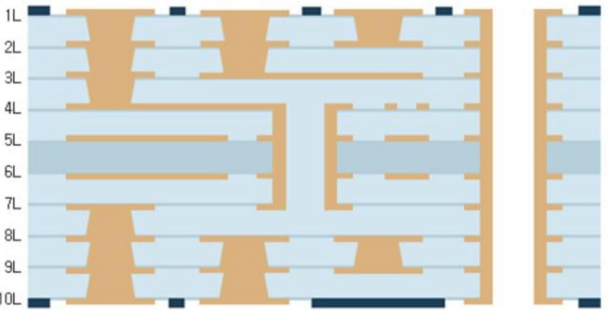
• B Type



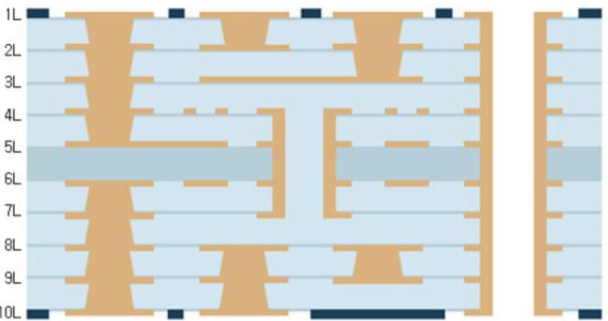
• C Type



• D Type



• 3D Type



• 4D Type

E

Environment

환경 정보 공개
환경 경영조직 설치
환경 교육
에너지 용수 사용

S

Social

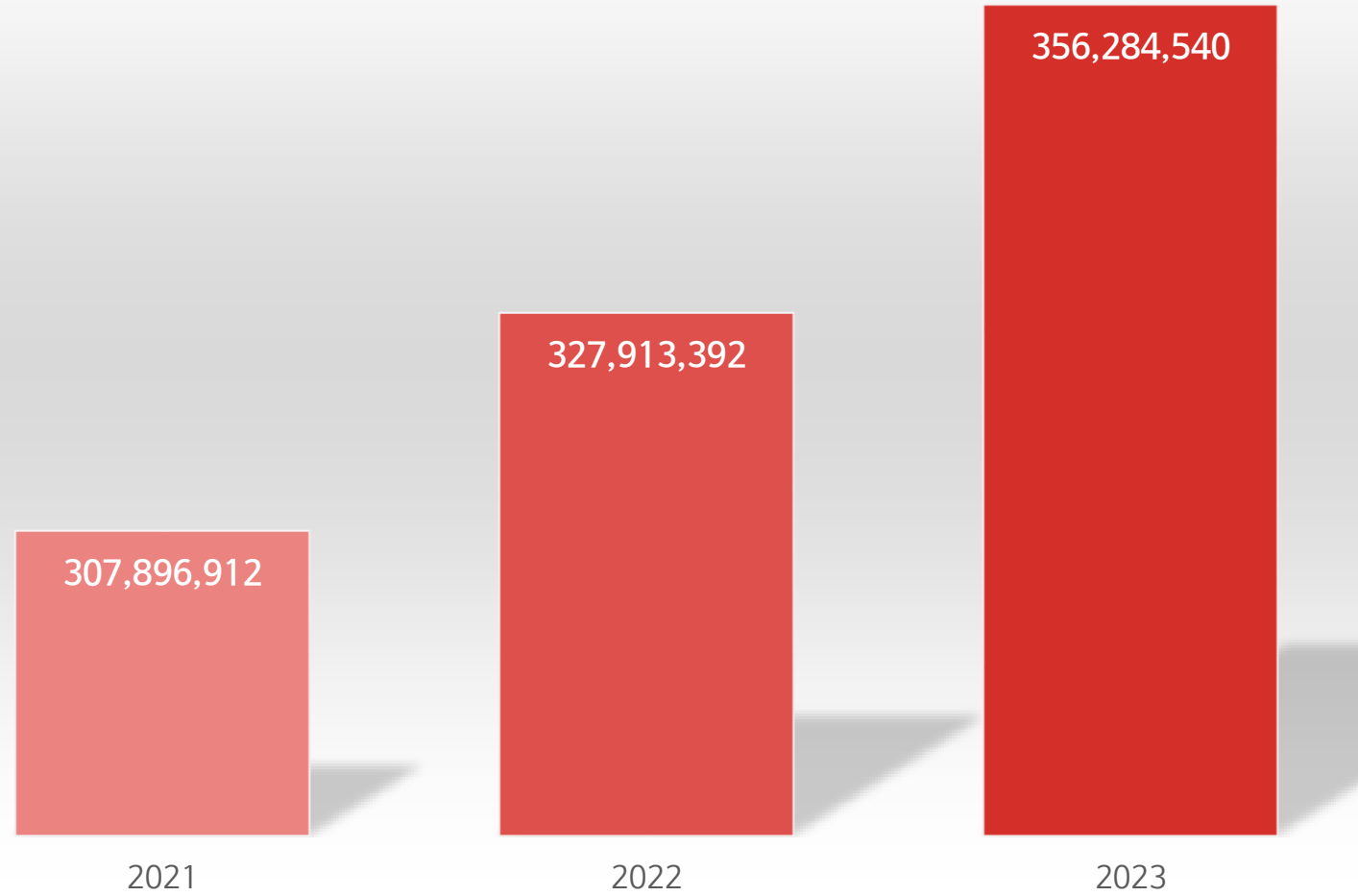
인권보호 정책 보유
공정거래/반부패 프로그램
소비자 안전 관련 인증
정보보호 안전 관련 인증

G

Govenance

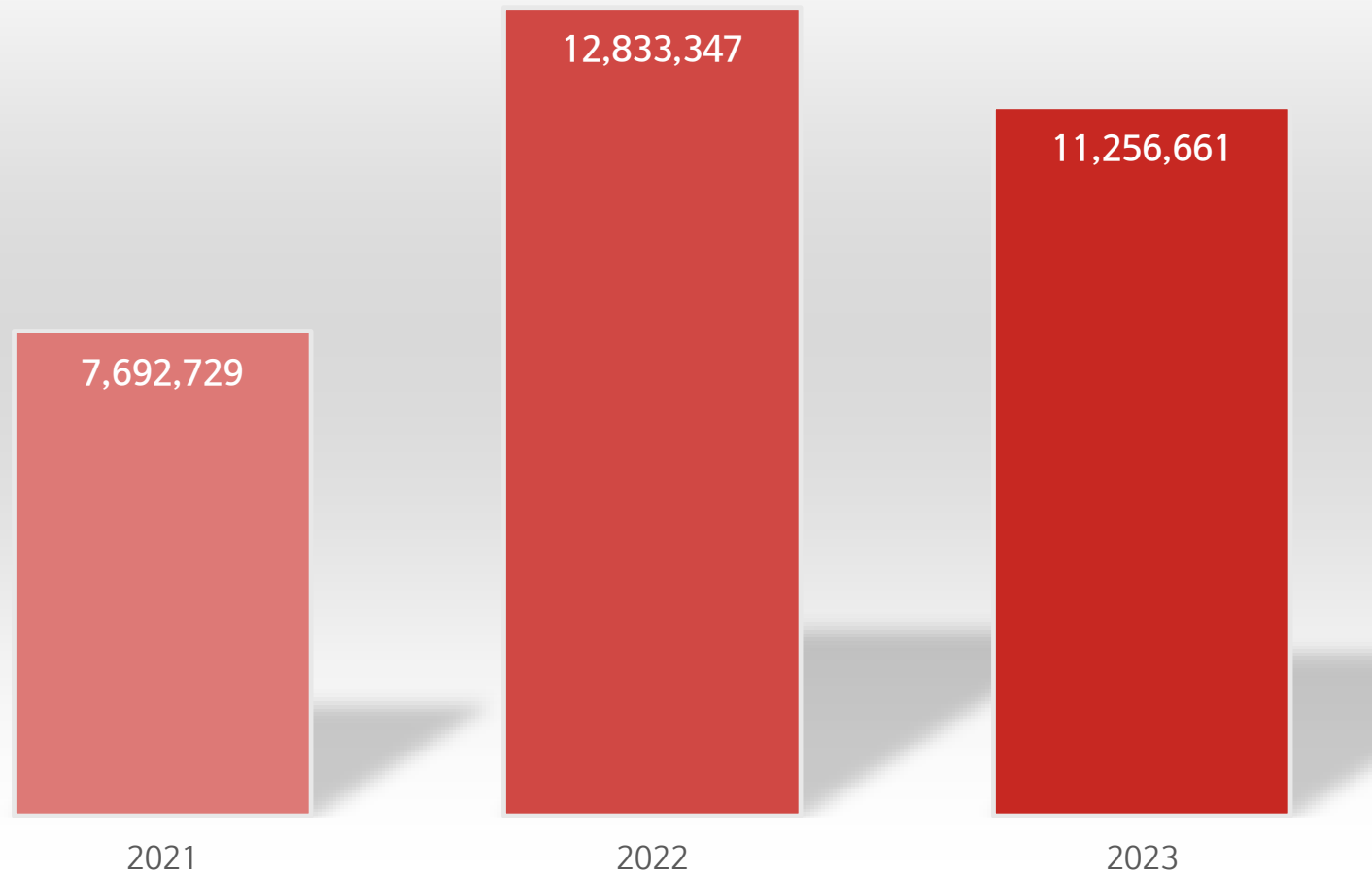
주주의결권 행사 지원제도
대표/이사회 독립성
감사 업무 교육 실시
지배구조 정보 공개

(단위:천원)



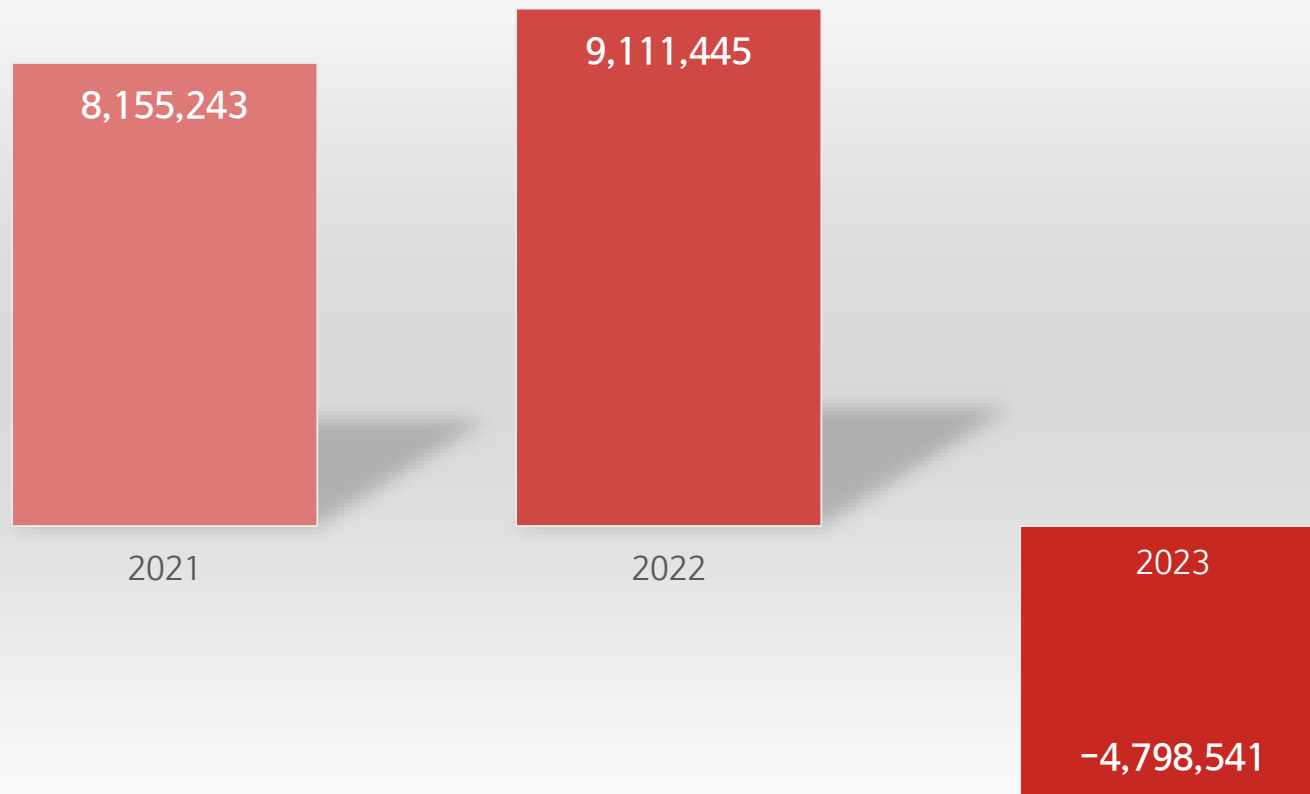
자료: 디에이피

(단위:천원)



자료: 디에이피

(단위:천원)

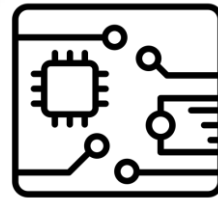




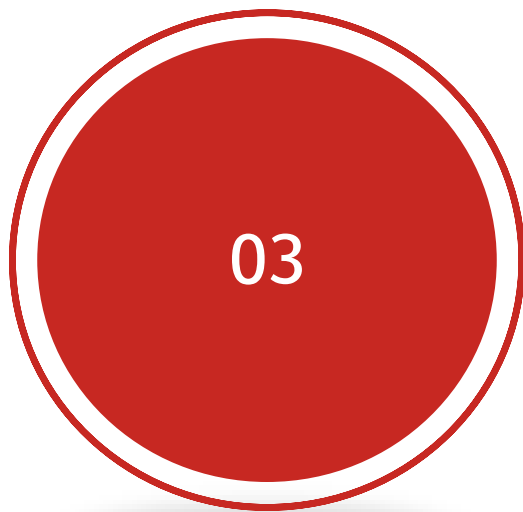
종속항공사
신규 노선 및 항공기 불충분
연료 가격 변동 및 LCC 업체들 간
경쟁 심화



23년 8월 이후 **항공기 3대 추가 도입**
오사카, 타이베이 등 **신규 취항**

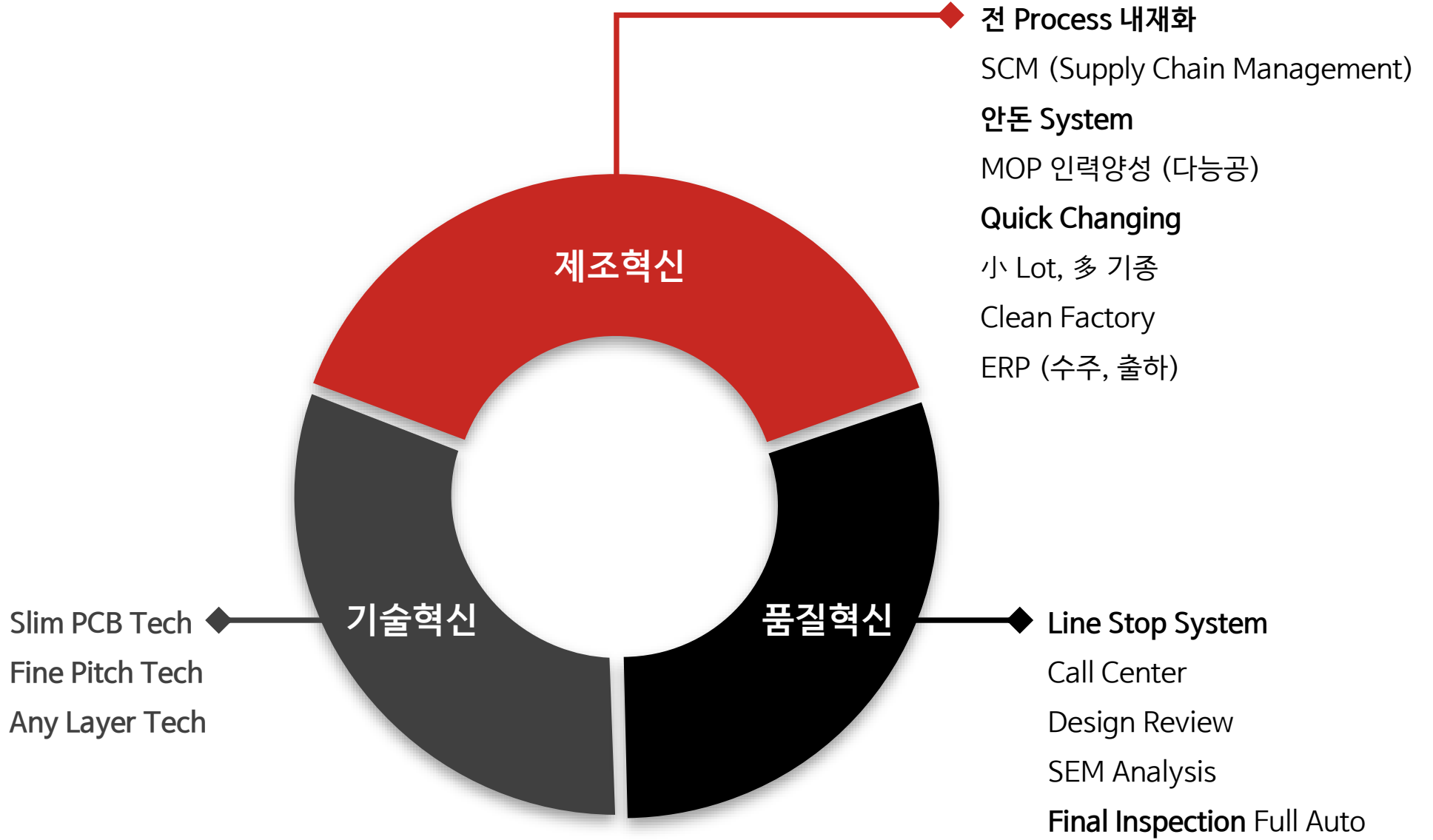


계속적인 **PCB 수요 증가**
자동차 전장 **매출 성장**



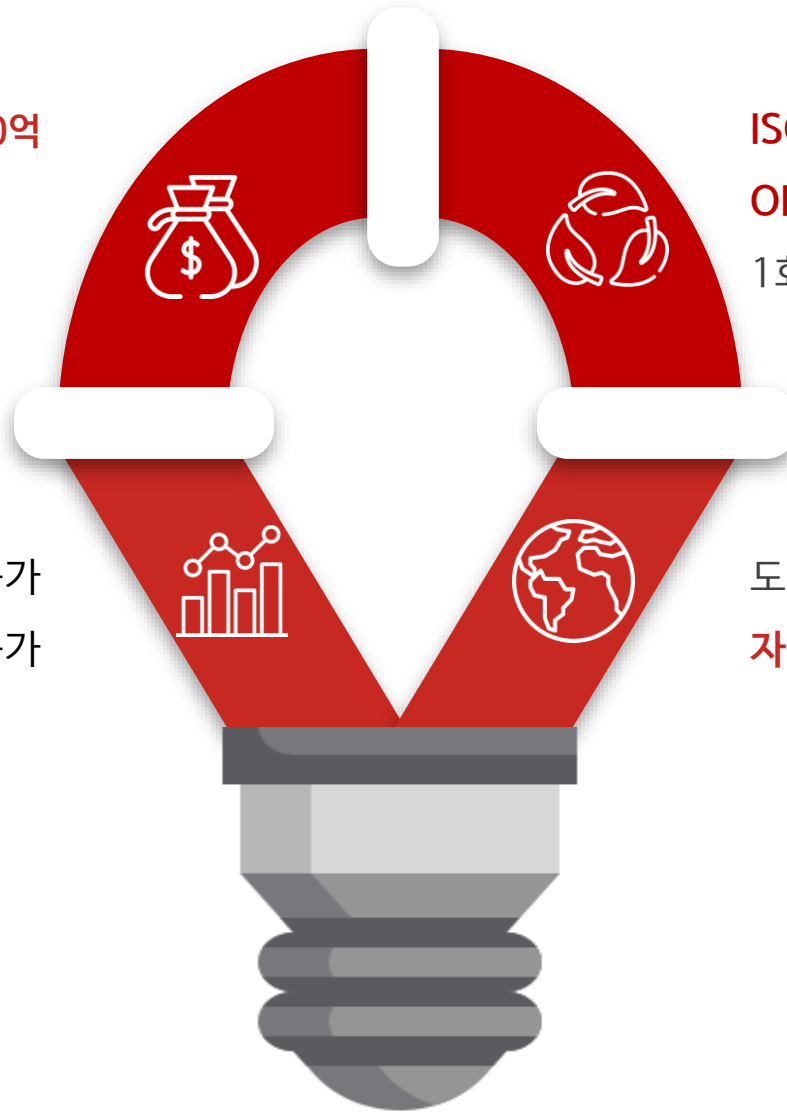
기업 전략

三
人
法



CAPEX 전분기대비 7억 → 20억
185.71% 상승

영업활동현금흐름 전년대비 2배 이상 증가
투자활동현금흐름 전년대비 3배 이상 증가



ISO 14001 시스템 운영
OHSAS 18001 인증 취득
1회/6개월 Item별 환경 유해물질 분석 실시

도요타, 재규어 등
자동차 전장향 PCB 해외 수출

연구개발

이동통신단말용 PCB 뿐 아니라
자동차 전장화로 인한 성장세에 따라
지속적인 연구개발으로
제품 수요처 다각화

추진분야

D/F 회로 구현 기술
MLB 기술
Laser / CNC Drill 최적 가공성
PSR 및 표면처리
Via Hole Plating 기술

신기술 공법개발



제조기술 개발



특화 원부자재 개발



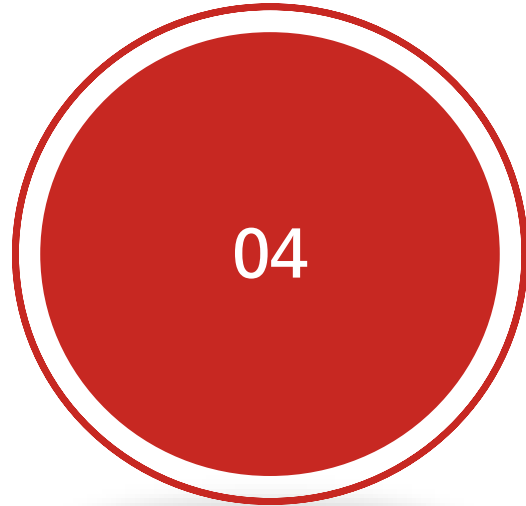
Q. 특허관련부서 유무와 어떤 방식으로 특허를 관리하는지

“

특허관련부서를 통해
꾸준한 특허법 관련 전공 지원자 모집



”

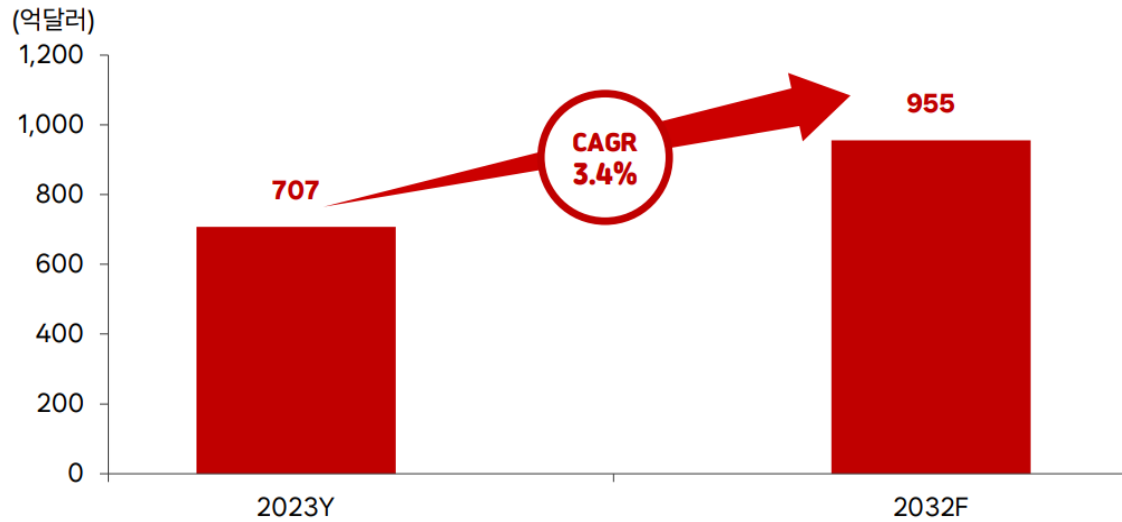


산업 환경 분석

三
人
法

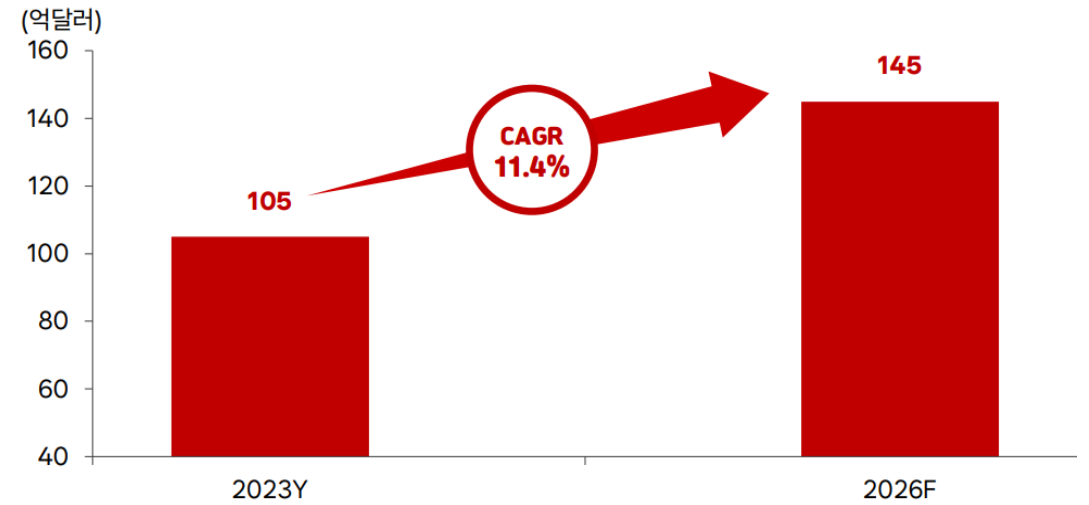


전체 PCB 시장 규모 전망



자료: IMAC, 한국IR협의회 기업리서치센터

차량용 PCB 시장 규모 전망



자료: 트렌드포스, 한국IR협의회 기업리서치센터

지난 몇 년 주춤했던
전세계 IT 지출
2024년 회복세 전망

AI 기술발전을 통한
반도체 수요 자극

자동차 시장의
친환경차 보급과
ADAS (첨단 운전자 지원
시스템)
도입을 통한
부품 수요 증가

삼성전자의
차량용 인포테인먼트 US 3.1
메모리 솔루션 양산 시작

LG전자의
자동차 전장사업 매출
2030년까지 20조원 이상 확대



안성사업장 (모바일 HDI PCB 중심)

소비자 → 모바일 업체 (삼성전자 등) → 디에이피



안산공장 (자동차 전장향 PCB 중심)

소비자 → 자동차 제조 업체 (현대모비스, LG전자 등) → 디에이피



Korea Circuit

PCB 산업

2023년 매출액 21% 감소,
부채비율 13% 증가

하이엔드 제품으로
매출 영역 확대 구상



YP Electronics

FPCB 산업

2022년 매출액, 영업이익,
당기순이익 30% 이상 감소
부채비율 54% 감소

IoT 시장 선점을 위한 노력



Interflex

FPCB 산업

2023년 영업이익 감소
및 성장성 하위
부채비율 21% 감소

광 FPCB 등 기술개발 성과



과거 이동통신단말기용
PCB 비중 90%에서
차량용 레이더 기관 상용화
자동차전장용 PCB 비중 확대

Build-up PCB
경박단소화 구현 기술 개발
0.25mm, 20/20 μ m
축소 성공



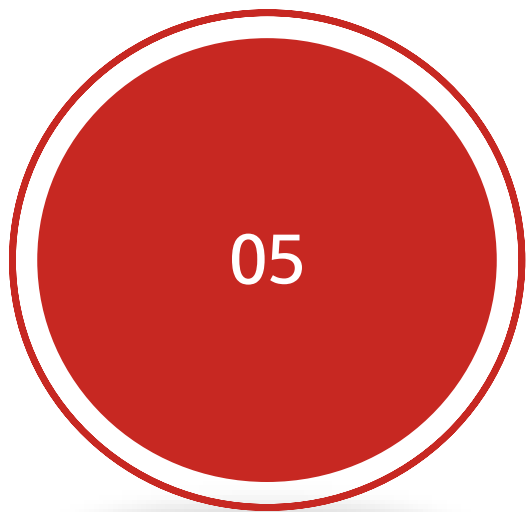
국내 HDI PCB '빅3'업체
(삼성전기, LG이노텍,
대덕전자)
사업 철수로 경쟁구도 개편

현대기아차 부품 국산화로
PCB 공급망에 포함된
자사 수혜 증가



세계 모바일 시장 정체
스마트폰향 HDI 매출 및
이익 감소 예상

자동차 전장향 매출 증가로
해결 가능



채용

人法





프로



책임

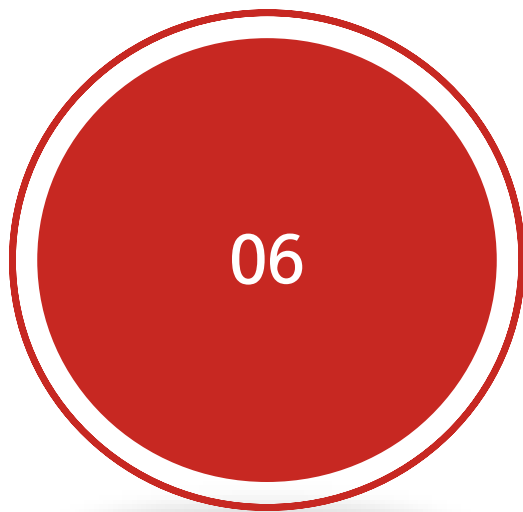


사랑



도전

상시 채용 시스템 운영
인재 DB 등록시스템 수립



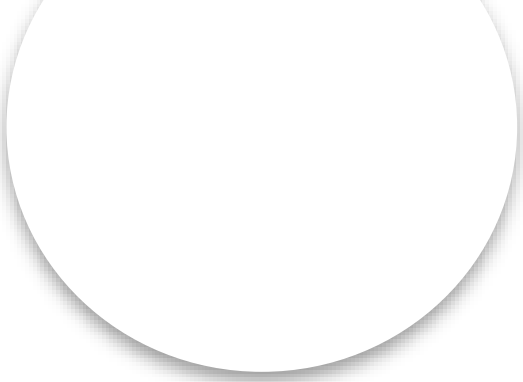
마무리

三
人
法

품질 혁신 및 공정 효율화를 위한
프로세스 구축

자동차 전장용 PCB의 상용화로
적용 분야 확대

ESG경영 강화



2024 한경국립대학교 기업분석 경진대회

감사합니다.

삼법인

